

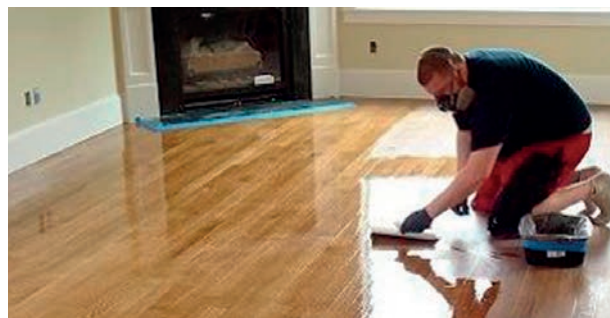
НИЗЬКОВ'ЯЗКІ ЕПОКСИДНІ ЗАЛИВНІ КОМПОЗИЦІЇ

Призначення

Виготовлення електроізоляційних шарів під час виробництва печатних електронних плат, трансформаторів «сухого» типу, низьков'язких епоксидних клейових композицій із високою адгезією до різних матеріалів для потреб приладостроювання, хімічної промисловості

Характеристики

Зовнішній вигляд	прозора рідина
В'язкість по Хепслеру, Па·с (25 °С)	≥1,4
Твердіння	«холодне» (10 – 20 °С) або «гаряче» (80 – 120 °С)
Адгезія на зсув, МПа (сталь Ст-3)	≥16,0



Низьков'язкі епоксидні композиції та напрями їх застосування

Переваги

Проти відомих аналогів має знижену в'язкість, підвищену адгезію до різних матеріалів, покращені захисні властивості, спрощену технологію виробництва, стабільну у разі тривалого зберігання

Рівень готовності розробки. Пропозиції до комерціалізації

TRL4, TRL4

На замовлення здійснюється виготовлення та постачання дрібних партій продукту

Охорона інтелектуальної власності

IPR1

Контактна інформація

Толстов Олександр Леонідович, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, +38 044 291 02 08, e-mail: tolstov@nas.gov.ua